

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年4月16日(2009.4.16)

【公開番号】特開2007-59892(P2007-59892A)

【公開日】平成19年3月8日(2007.3.8)

【年通号数】公開・登録公報2007-009

【出願番号】特願2006-202485(P2006-202485)

【国際特許分類】

H 05 K	1/09	(2006.01)
B 05 D	7/14	(2006.01)
B 05 D	7/24	(2006.01)
B 32 B	15/088	(2006.01)
H 05 K	1/03	(2006.01)

【F I】

H 05 K	1/09	A
B 05 D	7/14	B
B 05 D	7/24	3 0 2 X
B 32 B	15/08	R
H 05 K	1/03	6 7 0 A

【手続補正書】

【提出日】平成21年3月2日(2009.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

銅箔表面にポリイミド前駆体樹脂溶液を塗工し、続く熱処理工程で乾燥及び硬化を行い、銅箔とポリイミド樹脂層からなる銅張積層板を製造する方法において、銅箔に電解銅箔を用い、前記熱処理工程において、300～450の温度範囲で保持することで、前記銅箔の平均結晶粒径を熱処理工程前の2～8倍に成長させることを特徴とする高屈曲性フレキシブル銅張積層板の製造方法。

【請求項2】

熱処理工程前における銅箔の平均結晶粒径が0.5～2μmの範囲にある請求項1記載の高屈曲性フレキシブル銅張積層板の製造方法。

【請求項3】

熱処理工程において、300～450の温度範囲で3～40分間保持する請求項1又は2に記載の高屈曲性フレキシブル銅張積層板の製造方法。